

CORE 230 免洗 药芯焊线



特点

- 优化用于无铅组装工艺
- 对无铅加工表面（包括浸 Ag、ENIG 和 OSP）润湿速度快，润湿度好
- 符合Bellcore GR-78
- 防焦化
- 低飞溅，异味少

前言

CORE 230 焊线带有与钢泰NC-SMQ230无铅焊膏完全兼容的免洗助焊剂芯。它含有热稳定松香，对无铅焊装工艺中使用的各种金属表面具有出色的润湿型和扩散性。

产品描述

卷轴重量	500g 或 1lb
助焊剂百分比	2.7-3.2% (重量)
采用合金	Per J-STD-006 Variation C Sn95.5 Ag3.8 Cu0.7

焊线直径

Core 230 焊线500g 卷轴每卷包装长度	
焊线直径	Sn95.5 Ag3.8 Cu0.7
0.010" ±.002" (.254mm ±.051mm)	1996ft (608m)
0.015" ±.002" (.381mm ±.051mm)	2087ft (636m)
0.020" ±.002" (.508mm ±.051mm)	1174ft (357.7m)
.032" ±.002" (.813mm ±.051mm)	459ft (139.8m)

以上仅为近似值。实际长度可有所差异。

去除残留物

CORE 230中的助焊剂为免洗焊装工艺配方制成。如果封装外观或最终应用要求去除回流后残留物，可使用标准松香基残留物去除技术，包括但不限于空气喷雾、沉浸喷雾、蒸汽去油或超声波类型的清洗工艺。

存放

CORE 230 如果存放在干燥无腐蚀环境（如低湿度干燥的柜子）中，存放期为2年。存放时应避免日光直接照射、过度潮湿并远离热源。

补充产品

- NC-SMQ230 焊膏
- TACflux 023
- NC-771 助焊剂笔
- Wave Solder Flux 1075-EXR 46

技术支持

钢泰公司具有国际经验的工程师向顾客提供深入的技术协助。我们的技术工程师对材料科学各领域在电子和半导体行业中的应用拥有全面的知识，可就焊料特性、合金兼容性以及选用焊料预成形、焊线、焊带、焊箔和焊膏提供专家建议。钢泰公司的技术支持工程师对所有技术咨询提供迅速反馈(Rapid Response)。

产品数据表

本产品的产品数据表(MSDS)可上网查阅：
<http://www.indium.com/techlibrary/msds.php>。



BELLCORE 和 J-STD 测试与测试结果

测试	结果	测试	结果
J-STD-004 (IPC-TM-650)		Bellcore GR-78	
• 助焊剂类型分级	ROL1	• SIR (表面绝缘电阻)	通过
• 助焊剂腐蚀 (铜镜试验)	通过		
• 含有卤化物 氟化物物点试验 元素分析 (Br, Cl, F)	通过 0%		
• 腐蚀性试验	通过		
• SIR (表面绝缘电阻)	通过		

所有资料均仅供参考。不得用作收到产品之规格。

本产品数据表仅提供一般信息。本资料无意提供也不应视作对有关产品性能的保证或担保。售出产品只承诺随产品包装及发票提供的书面保证及有关限制条件。

表格编号 98181(SC A4) R0

焊料

INDIUM CORPORATION®

www.indium.com
china@indium.com
中国 +86 (0)512 628 34900
新加坡 +65 6268 8678
英国 +44 (0) 1908 580400
美国 +1 315 853 4900



经
ISO 9001
注册